

応用物理学会春季学術講演会・一般公開シンポジウム

JSAPシリコンテクノロジー分科会・エレクトロニクス実装学会 共催

# 実装技術アラカルト： 最先端半導体実装技術の挑戦と将来展望

2024年3月22日(金) 13:30~17:30

東京都市大学 世田谷キャンパス（7号館・71A） & オンライン

異種機能デバイスとシリコンUSLIとの融合・集積によるMore than Moore技術には、近年、発展著しい実装技術が貢献しており、多様なアイデア、新材料・新プロセス技術の開発が進んでいます。今回、当分科会では、様々な分野の最先端実装技術を網羅的に紹介し、異分野間の課題・知見の共有、協働のきっかけとなる議論の場を提供します。

**2nm時代を前にした半導体パッケージ技術**

野中 敏央（Rapidus株式会社）

**小型Siフォトニクス光トランシーバチップの実装技術**

竹村 浩一（アイオーコア株式会社）

**先端半導体パッケージに向けた  
ダイレクト露光技術の拡張と革新**

矢島 英樹、小林 義則（株式会社オーク製作所）

**マイクロプロセッサ、パワーエレクトロニクス  
における熱設計・熱制御**

西 剛伺（足利大学）

**次世代車載用パワー半導体応用戦略**

山本 真義（名古屋大学）

**CMOSイメージセンサにおける3D積層技術の現状と展望**

岩元 勇人（ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社）